

SMコンタクト

SM contact

SM-V series

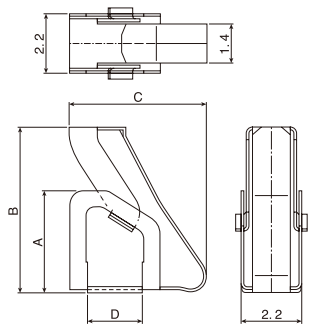


材 質 /Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)

メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating

推奨使用範囲 /Recommended operating range SM-V384022-PB
高さ = 2.5 ~ 3.8mm Height: 2.5 mm to 3.8 mm
SM-V506022-PB
高さ = 3.7 ~ 5.8mm Height: 3.7 mm to 5.8 mm

[単位 Unit:mm]

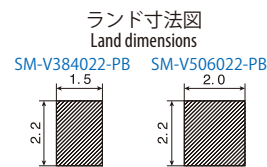


用途

Applications

パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、
家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



品番表

Product list

品番 Product code	寸法 [mm] Dimensions [mm]				標準梱包数量 Standard packaging quantity	
	A	B	C	D	テーピング Taping	ダンボール Corrugated cardboard
SM-V384022-PB	2.3	4.0	3.75	1.5	5,000ヶ (リール) /実数5,001ヶ(1ヶ予備) 5,000/reel; Actual quantity: 5,001 (one spare)	60,000ヶ (外箱) 12リール/1箱 梱包 60,000/box (12 reels are packed in each box.)
SM-V506022-PB	3.7	6.0	5.0	2.0	1,500ヶ (リール) 1,500/reel	21,000ヶ (外箱) 14リール/1箱 梱包 21,000/box (14 reels are packed in each box.)

特性

Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.05Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	1.0N以下 (SM-V384022-PB) 1.0 N or less (SM-V384022-PB) 2.6N以下 (SM-V506022-PB) 2.6 N or less (SM-V506022-PB)	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の反発力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 85°C 処理時間: 500hr
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 65°C/95%RH 処理時間: 500hr
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40°C 処理時間: 500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40°C(1hr)~85°C(1hr) 処理時間: 100 サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 (SM-V384022-PB) 30% or less (SM-V384022-PB) 25%以下 (SM-V506022-PB) 25% or less (SM-V506022-PB)	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40°C(1hr)~85°C(1hr) 処理時間: 12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) ×100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペース高さ
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。半田温度: 245±3°C 浸漬時間: 3 sec.